

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 24 年 9 月 20 日 (2012.9.20)

【公開番号】特開 2011-191407 (P2011-191407A)

【公開日】平成 23 年 9 月 29 日 (2011.9.29)

【年通号数】公開・登録公報 2011-039

【出願番号】特願 2010-56148 (P2010-56148)

【国際特許分類】

G 0 2 B 3/14 (2006.01)

G 0 2 B 26/00 (2006.01)

【F I】

G 0 2 B 3/14

G 0 2 B 26/00

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 8 月 6 日 (2012.8.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 7】

請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 項において、
前記密閉容器は、
前記第 1 室の空間を形成する第 1 凹部を有する第 1 室構造体と、
前記第 2 室の空間を形成する第 2 凹部を有する第 2 室構造体と、
前記第 1 室構造体の前記第 1 凹部側及び前記第 2 室構造体の前記第 2 凹部側を覆うように、前記第 1 室構造体と前記第 2 室構造体の間に接合され、前記仕切壁として機能するとともに前記開口部を有する仕切板と、
から構成されることを特徴とする可変焦点レンズ。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 7】

(発明 7) : 発明 7 に係る可変焦点レンズは、発明 1 乃至 6 のいずれか 1 項において、
前記密閉容器は、前記第 1 室の空間を形成する第 1 凹部を有する第 1 室構造体と、前記第 2 室の空間を形成する第 2 凹部を有する第 2 室構造体と、前記第 1 室構造体の前記第 1 凹部側及び前記第 2 室構造体の前記第 2 凹部側を覆うように、前記第 1 室構造体と前記第 2 室構造体の間に接合され、前記仕切壁として機能するとともに前記開口部を有する仕切板と、から構成されることを特徴とする。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 1】

側壁部材 3 4、4 4 は、光透過性の有る部材（透明部材）であってもよいし、光透過性

を有しない部材（非透明の部材）であってもよい。本例の場合、側壁部材 3 4 は、底板部材 3 3 と一体の透明なガラス材で構成される。また、側壁部材 4 4 は、天板部材 4 3 と一体の透明なガラス材で構成される。例えば、ガラス基板の片面を削って第 1 液室 1 4 の空間部となる凹部（「第 1 凹部」に相当）を形成することにより第 1 室構造体 3 2 を得ることができる。同様に、ガラス基板の片面を削って第 2 液室 2 4 の空間部となる凹部（「第 2 凹部」に相当）を形成することにより第 2 室構造体 4 2 を得ることができる。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 6 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 6 8】

さらに、5 0 V、1 m s のパルス波を印加したときの振動板の変位をレーザードップラー振動計で計測したところ、上述の直流電圧印加時と同様の変位量が得られ、残留振動は無かった。このことから、1 m s 以内に振動板が変形していることがわかり、高速応答が可能であることが確認された。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

A detailed cross-sectional diagram of a semiconductor device. The device consists of several stacked layers. At the top is a thin layer labeled 10. Below it is a thicker layer labeled 16, which contains a central rectangular region labeled 24. This region 24 is filled with a material having a dashed pattern, representing a conductive or doped layer. On either side of region 24 are regions labeled 18 and 14, also containing dashed patterns. Below these is another layer labeled 12, which has a hatched pattern. At the bottom is a substrate layer labeled 52, also with a hatched pattern. Various other features are indicated by labels: 30 points to the top surface of layer 16; 31 points to the interface between 16 and 12; 32 points to the right edge of the device; 33 and 34 point to specific areas within the 12 layer; 36 points to the left edge; 37 points to the interface between 12 and 52; 38 points to a small feature on the left side of the 12 layer; 39 points to a small feature on the right side of the 12 layer; 40 points to a small feature on the left side of the 12 layer; 41 points to a small feature on the right side of the 12 layer; 42 and 43 point to the top surface of the 10 layer; 44 points to the top surface of the 16 layer; 45 points to the top surface of the 12 layer; 46 points to the top surface of the 52 layer; 47 points to the top surface of the 10 layer; 48 points to the top surface of the 16 layer; 49 points to the top surface of the 12 layer; 50 points to the top surface of the 52 layer; 51 points to the top surface of the 10 layer; 53 points to the top surface of the 16 layer; 54 points to the top surface of the 12 layer; 55 points to the top surface of the 52 layer; 56 points to the top surface of the 10 layer; 57 points to the top surface of the 16 layer; 58 points to the top surface of the 12 layer; 59 points to the top surface of the 52 layer.